

第6回フラウンホーファーシンポジウム in SENDAI 6th Fraunhofer-Gesellschaft Symposium in SENDAI

2010年12月7日(火)9:30～ 仙台サンプラザ 3Fクリスタルルーム
December 7, 2010 (Tue.) 9:30- Sendai Sunplaza, 3F Crystal Room

プログラム ※日英同時通訳付き

- 9:30-9:35 **開会の辞**
奥山恵美子氏(仙台市長)
- 9:35-9:40 **ご挨拶**
江刺正喜教授(東北大学原子分子材料科学高等
研究機構教授)
- 9:40-9:55 **フラウンホーファー研究機構のご紹介**
ロレンツ・グランラート
(フラウンホーファー日本代表部代表)
- 9:55-10:30 **スマートシステム・インテグレーション ～フラウン
ホーファーENASのビジネスユニットおよびコア・コ
ンピタンス～**
トーマス・ゲスナー
(フラウンホーファーENAS所長)
- 10:30-11:05 **システム・イン・パッケージ
～ウエハとボードレベルでの技術～**
クラウド＝ディーター・ラング
(フラウンホーファーIZM所長)

Program *with English-Japanese Interpretation

- Opening**
Ms. Emiko OKUYAMA (Mayor, the City of Sendai)
- Welcome Address**
Prof. Masayoshi ESASHI (Professor, WPI Advanced
Institute for Material Research, Tohoku University)
- Introduction of Fraunhofer-Gesellschaft**
Dr. Lorenz GRANRATH (Representative, Fraunhofer
Representative Office Japan)
- Smart System Integration - Business Units and
Core Competencies of Fraunhofer ENAS**
Prof. Thomas GESSNER (Director, Fraunhofer Research
Institution for Electronic Nano System ENAS)
- System in Package - Technologies at
Wafer and Board Level**
Dr. Klaus-Dieter LANG (Director, Fraunhofer Institute
for Reliability and Microintegration IZM)

11:05-11:40	<p>マイクロエレクトロニクスのオンチップと3次元配線 ～プロセス、材料、特性評価～ エーレンフリート・チェッヒ (フラウンホーファーIZFPナノ分析部門長)</p>	<p>On-Chip and 3D Interconnects in Microelectronics - Processes, Materials, Characterization - Prof. Ehrenfried ZSCHECH (Head of Department, Fraunhofer Institute for Non-Destructive Testing IZFP)</p>
11:40-12:15	<p>極薄層の新しいアプリケーションとマイクロ・ナノ技 術におけるレイヤーシステム アンドレアス・レゾン (フラウンホーファーIWS所長代理)</p>	<p>New Applications of Ultrathin Layers and Layer Systems in Micro- and Nanotechnology Dr. Andreas LESON (Deputy Director, Fraunhofer Institute for Material and Beam Technology IWS)</p>
12:15-13:30	<p>昼食</p>	<p>Lunch</p>
13:30-14:00	<p>MEMSウエハレベル・パッケージングにおける金属 の熱圧着接合 ヨーク・フレーメル (フラウンホーファーENASシステムパッケージ 部門長代理)</p>	<p>Metal Thermo Compression Bonding for Wafer Level Packaging of MEMS Mr. Jörg FRÖMEL (Deputy Head of Department Fraunhofer Research Institution for Electronic Nano System ENAS)</p>
14:00-14:30	<p>WPI-AIMRとフラウンホーファーとの融合研究 山本嘉則教授 (東北大学原子分子材料科学高等研究機構長)</p>	<p>Fusion Research Between WPI-AIMR and Fraunhofer Prof. Yoshinori YAMAMOTO (Director, WPI Advanced Institute for Material Research, Tohoku University)</p>
14:30-15:00	<p>日独共同研究における革新材料MEMS 林育菁助教 (東北大学原子分子材料科学高等研究機構助教)</p>	<p>Japanese-German Cooperative Research on In- novative Material MEMS Assis. Prof. Yu-Ching LIN (WPI Advanced Institute for Material Research, Tohoku University)</p>
15:00-15:10	<p>仙台地域における産学連携による新産業創出の取組み 宮田寛之氏 (仙台市経済局産学連携課長)</p>	<p>Introduction: Activity of the City of Sendai Mr. Hiroyuki MIYATA (Director, Industry Academia Collaboration Promotion Section, City of Sendai)</p>
15:10	<p>閉会</p>	<p>Closing</p>